规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoJLRX2512系列产品选型。

■ 产品特点Features

合金芯片，封体工艺，焊接性能良好

高可靠性，高过载能力，产品精度高

使用温度范围较宽无感型设计

符合 ROHS 要求和无卤要求

■ 产品名称Product Name

封体合金电阻

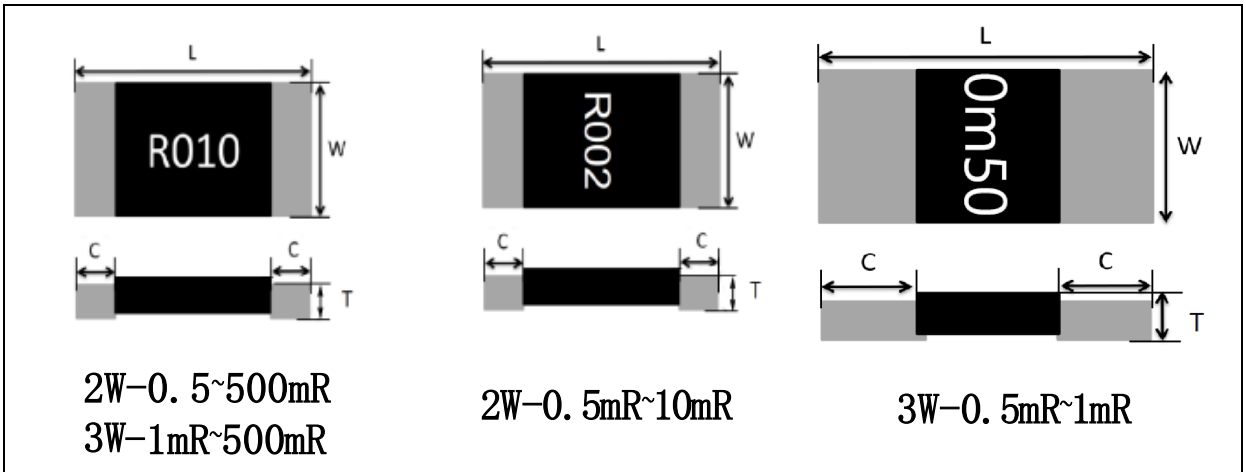
■ 产品型号Product number

Ho	JLRX	2512	3W	100mR	1%
制造商	产品类别	封装	额定功率	阻值	精度
毫欧电子	封体合金	2512	2W	0.5~10mR	D=±0.5% F=±1% J=±5%
			(2W、3W)	0.5~500mR	

具体参数请查看下页详情

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 产品尺寸 Product size (Unit:mm)



2W-0.5~500mR
3W-1mR~500mR

2W-0.5mR~10mR

3W-0.5mR~1mR

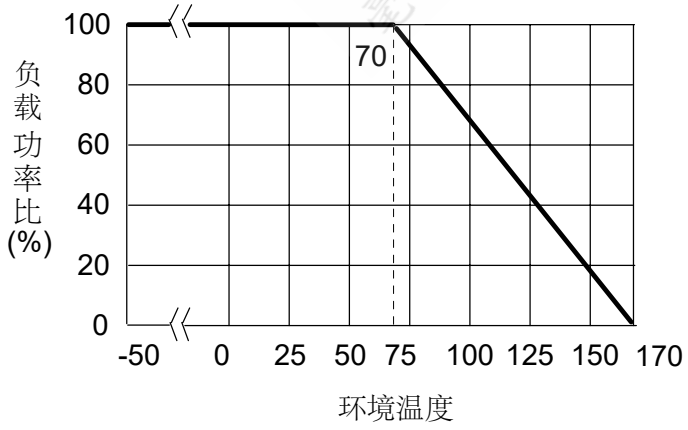
封装	阻值	功率	L	W	C	T
2512	0.5~10mR	2W	6.4±0.2	3.2±0.2	0.9±0.2	0.6±0.2
	1~500mR	2W、3W	6.4±0.2	3.2±0.2	0.9±0.2	0.7±0.2

■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	2W、3W
阻值范围 Resistance range	0.5mR~500mR
最大额定电流 Max.Rated Current	2.45A~77.45A
准确度等级 AccuracyClass	0.5%、1%、5%
电阻温度系数 T.C.R (ppm / ℃)	±50 (2mR~500mR)、±100 (0.5mR~1mR)
工作温度范围 Operating Temperature Range	-50℃~+170℃

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 50 ～+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图

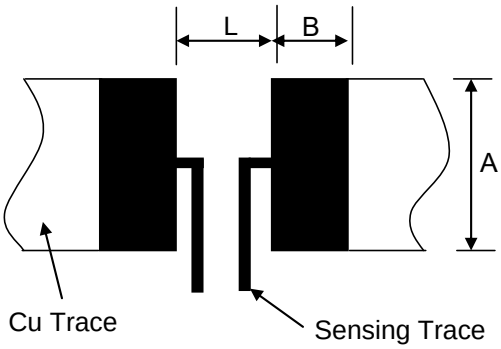


■ **额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu**

$$I = \sqrt{P/R}$$

I :Rated Current (A)
P:Rated Power (W)
R:Resistance Value (Ω)

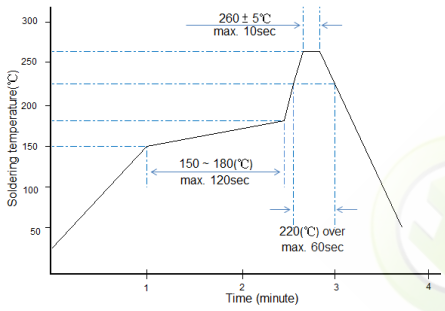
■ **建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension** (Unit:mm)



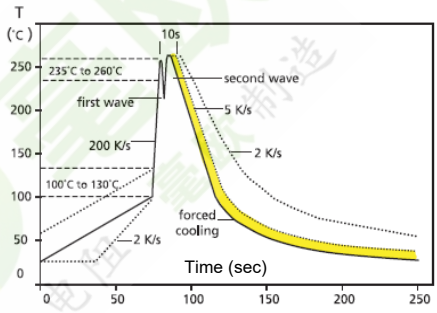
封装	阻值mR	A	L	B
2512	0.5~500	4.0	4.1	2.1

■ **建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters**

预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 ， 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒 峰值: 260±5℃,5秒.

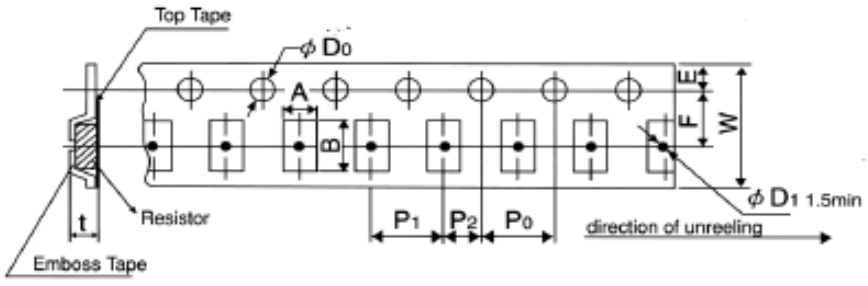


回流焊曲线图



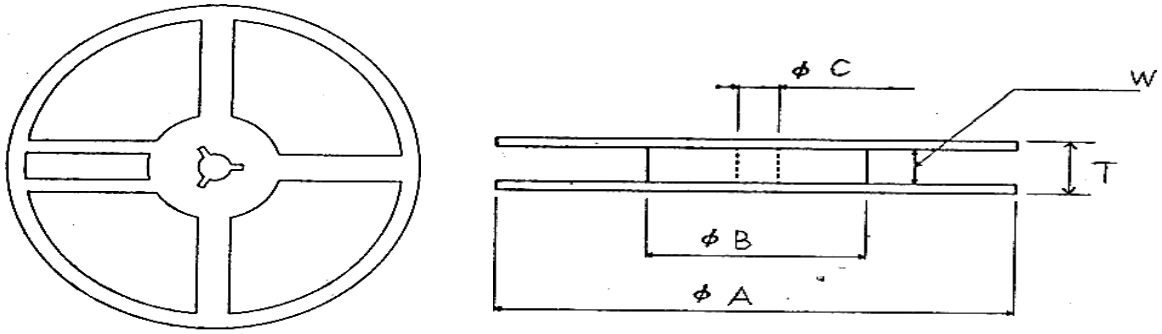
波峰焊曲线图

■ **彩带尺寸 Ribbon size**(Unit:mm)



A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
3.6±0.2	6.9±0.2	12±0.2	5.5±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1	2±0.05	4±0.05	Φ 1.5+0.1	0.85±0.15

■ 卷轴规格 Reel Specification



Φ A	Φ B	Φ C	W	T	Packaging Quantity
178±2	60±1	13±1	9±1	15.4±2	4000PCS

■ 可靠性测试 Reliability Tests

Test Items	Reference standard	Condition of Test	Test Limits
Temperature Coefficient of Resistance	IEC60115-1-4.8 JIS-C5201-4.8	+25℃ ~ +125℃	Refer 4.0
Load Life	IEC60115-1-4.25.1 JIS-C5201-4.25.1	1000hours at rated power, 70℃, 1.5hours “ON”, 0.5hour “OFF”	< ±1%
Short Time Overload	IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-4.13	2 X rated power for 5s	< ±1%
Moisture no Load	IEC60115-1- 4.24.2.1a) JIS-C5201- 4.24.2.1a)	85℃, 85%RH, 1000hrs	< ±1%
Temperature cycle	IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-4.19	-55℃ & +155℃, 100cycle, 15min per extreme condition	< ±1%
Resistance to Soldering Heat	IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18	260±5℃ for 10±1 sec	< ±0.5%
Solderability	IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17	245±5℃, 2±0.5sec	At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder
High Temperature Exposure	IEC60115-1- 4.23.2 JIS-C5201-4.23.2	155℃, 1000hrs	< ±1%
Low Temperature Storage	EC60115-1- 4.23.4 JIS-C5201-4.23.4	-55℃, 1000hrs	<±1%
Substrate Bending	IEC60115-1-4.33 JIS-C5201-4.33	Bending width 2mm	< ±0.5%
Insulation Resistance	IEC60115-1-4.6 JIS-C5201-4.6	100V DC for 1 minute	>100 MΩ

修改履历表：

序号	修改内容	修改日期	修改原因
1	更换尺寸规格	2021-10-22	更新
2	更换短时间过载测试倍数	2021-11-22	更新
2	取消大焊盘规格	2022-03-28	更新